



カッティングエッジ

CUTTING EDGE

71期中間事業のご報告

平成21年4月1日～平成21年9月30日



DISCO

Kiru・Kezuru・Migaku Technologies



Kiru, Kezuru, Migaku

Diamond Blade

「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術によって遠い科学を身近な快適につなぐ」

3つのコア技術を深めることで、ディスコは産業と暮らしに貢献しています。

① 高度なKiru・Kezuru・Migaku技術とは

「切る」「磨く」「磨く」は、古代から脈々と培われてきた人類に欠かせない技術です。ディスコはこの普遍的な技術を深化させ、またこの技術領域における世界のオンリーワンでありたいと考えています。「Kiru」「Kezuru」「Migaku」とローマ字表記しているのは、ディスコの技術が世界標準となり、日本語でそのまま通用するようなレベルを目指すという思いが込められているからです。

② 遠い科学を身近な快適につなぐとは

科学は日進月歩しています。しかしどれほど技術が進歩しようともそれだけでは社会の進歩や人類の幸せに役立つとは限りません。ディスコの技術によってそんな遠い科学を人々の暮らしの豊かさや快適さに帰結させていきたいという思いをこめています。

③ ディスコが追い求める成長とは

企業の軸として据えた社会的使命に則り、あらゆるステークホルダとの価値交換を通じ、長期的にわたる成長ストーリーを発信し、また実現していく。ディスコはそんな企業でありたいと考えています。

Tool of the Stone Age



半導体市場の好転と経費圧縮の効果で、
通期黒字化を想定しております。

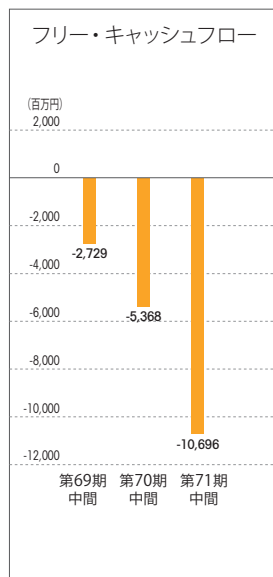
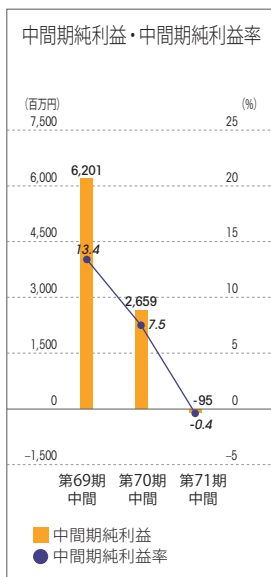
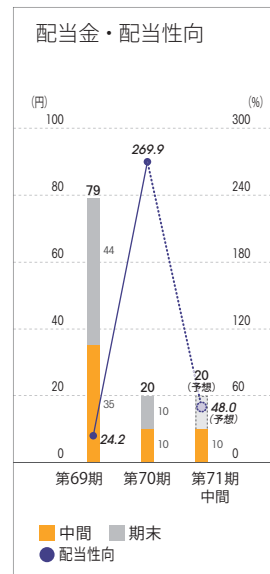
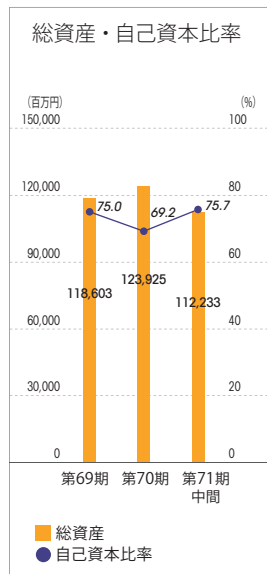
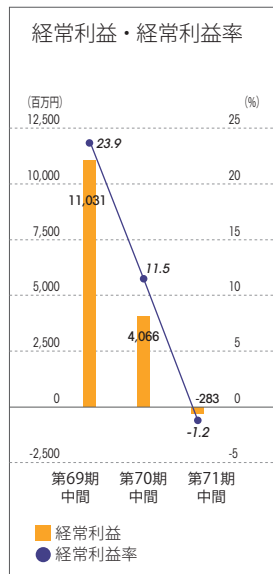
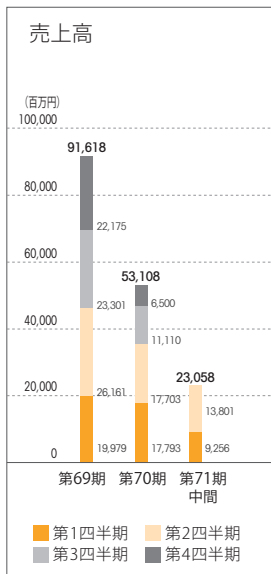
2009年度上半期の経済環境は、依然として不透明な状況が続いておりましたが、半導体業界においてはメーカ各社の生産調整が一巡し、稼働率が改善しております。当社グループにおきましても、精密加工ツールの売上がピーク時の7割程度まで回復し、精密加工装置の受注動向も好転しつつあります。また、いわゆる「LEDテレビ」に代表されるLED市場の急速な拡大を背景に、高輝度LEDを製造する工程にて使用されるレーザダイサの需要が大幅に増加いたしました。

このような状況の下、経費圧縮の効果や今後の半導体市況を勘案し、2010年3月期通期では、連結業績の黒字化を想定しております。

これからも将来を見据えた高水準な研究開発を進めていくと同時に、「テストカット」サービスを通じて最先端動向の把握に努め、お客さまからの様々な加工要求に柔軟に対応していきたいと考えております。そして、事業の長期的成長を目指しながら、当社ミッションの実現およびステークホルダーとの価値交換性の向上を図ってまいります。株主の皆さまからのさらなるご支援を賜りますようお願い申し上げます。



2009年12月



財政状態について

当中間期末の総資産は、1,122億33百万円(昨年度末比116億91百万円減)となりました。これは昨年度に不況対策の一環として実施した銀行借入(約270億円)のうち120億円を期限前弁済したことや有形固定資産取得代金の支払いなどによって、現金及び預金が減少したことが主な要因です。この結果、負債合計は266億20百万円(昨年度末比109億76百万円減)となったことから、自己資本比率は75.7%(昨年度末比6.5ポイント増)に改善いたしました。

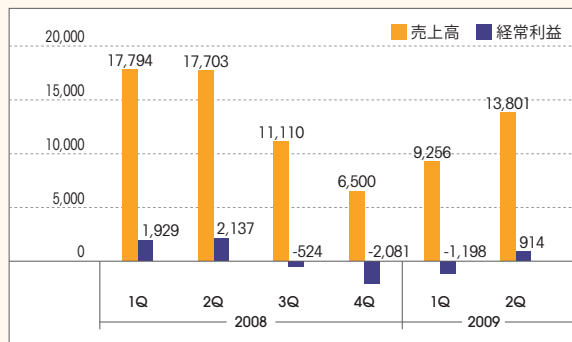
配当について

当社は業績に連動した配当を実施することを基本方針とし、配当性向は連結当期純利益の20%としておりますが、利益水準に関わらず安定配当として最低限年間20円を維持いたします。

当中間期末における配当は、配当性向20%を適用した場合10円を下回る金額となる為、安定配当である10円とさせていただきます。また、期末の配当につきましても通期の連結業績予想を勘案した結果、10円と予想しております。

※業績予想につきましては、6ページをご覧ください。

連結売上高 四半期推移 (百万円)



	2008年度				2009年度	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
売上高	17,794	17,703	11,110	6,500	9,256	13,801
営業利益	1,854	2,095	△1,018	△2,855	△1,142	963
経常利益	1,929	2,137	△524	△2,081	△1,198	914
純利益	1,253	1,405	△546	△1,862	△902	807

当期の概況

当中間期における世界経済は、第1四半期では景気の先行き不透明感が色濃く脆弱だったものの、第2四半期になると各国政府の行った景気刺激策や金融緩和政策が効果を発揮し、徐々に持ち直す兆しが出てきました。

当社グループが主力事業を展開する半導体業界では、メーカー各社の設備投資は低迷していましたが、在庫調整が一巡したことで、その生産稼働率は大きく改善しました。一方、ノートPCや液晶テレビなどのバックライトをLEDに代替する流れを受けて、高輝度LEDの増産に向けた設備投資拡大の動きも見られました。

このような事業環境において、当社グループは積極的な販売活動を展開する一方、一時帰休や経費コントロールなどの各種不況対策を行い、収益の改善に努めてまいりました。精密加工装置の引き合いは全般に低い水準となったものの、需要拡大が見込まれるLED向けレーザーの出荷数が過去最高となり、売上高の下支えに大きく貢献しました。また、精密加工ツールの販売は、半導体・電子部品の生産稼働率改善の動きに合わせ、ピーク時の7割程度まで回復しました。その結果、第2四半期においては、3四半期ぶりに営業黒字へと転換いたしました。

以上のような状況のもと、当中間期の売上高は230億58百万円(前年同期比35.0%減)となり、営業損失は1億79百万円(前年同期は39億49百万円の利益)となりました。経常損失は2億83百万円(同40億66百万円の利益)となり、中間期純損失は95百万円(同26億59百万円の利益)となりました。

通期の連結業績予想

景気は力強さに欠けるものの回復の兆しを見せており、半導体市場では一部地域において設備需要の回復傾向が見られます。当社グループにおきましては、特にLED切断用および一部組立て用装置の需要が堅調です。このような市場の状況を勘案した結果、平成22年3月期通期の連結業績は14億円の当期純利益となる見込みです。

(金額の単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
平成22年3月期	58,500	3,200	3,200	1,400	41.66円

拡大する LED市場を支える DISCOの技術

LEDの光が様々な生活場面でさらに身近になるように、ディスコはその高度な技術によって、LEDの輝きと生産性を向上させています。

LED市場環境

LEDは、携帯電話・ノートパソコン・テレビの液晶画面のバックライト向け用途に多く用いられておりますが、白熱灯や蛍光灯の代替として一般照明にも普及していくことが見込まれております。白熱電球と比べると消費電力は約1/10、寿命は約40倍といわれ、環境意識の高まりやLED電球自体の価格下落もあり、一般的な利用も広がっております。このように大きな需要が期待されるLEDですが、高輝度化・低消費電力化・長寿命化と同時に低価格化への要求も高まるが見込まれます。そのため、製造工程での一層のプロセス革新が求められています。

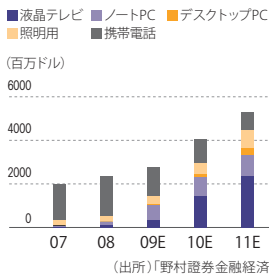
DISCOの技術

このようなLED市場において、ディスコは、LED基板向けの切断装置とその加工技術アプリケーションを提供しています。LEDメーカーでは、スルーカット^①・歩留まり^②向上の要求が強まり、レーザーによる加工が急速に普及しつつあります。ディスコでは、2009年4月に新たなソリューションとして、高輝度LEDの高品質、高歩留まり生産を実現するサファイア基板のステルスダイシング(SD)^③プロセスを開発しました。SDプロセスは、輝度の低下がほとんどないことから、高輝度を要求する高付加価値デバイスに適しており、また独特な切断方法のため、チップ取れ個数の増加も期待できます。これらのことからLEDメーカーからの引き合いが強まっています。

LEDとは？

電気を流すと発光する半導体の一種で、発光ダイオード(Light Emitting Diode)のこと。低消費電力で小型化がしやすく、寿命が長いのが特徴で、人類が手に入れた第4世代のあかりとして期待されている。

LEDの用途別市場見通し



用語解説	①スルーカット：	単位時間あたりの加工処理速度。
	②歩留まり：	チップ化の加工品質。
	③ステルスダイシング：	レーザーをワーク内部に集光することで内部に改質層を形成し、ブレーキングなどによりチップ分割を行う加工。

※浜松ホトニクス株式会社との業務提携による加工技術

フルオートマッチックレーザーDFL7340

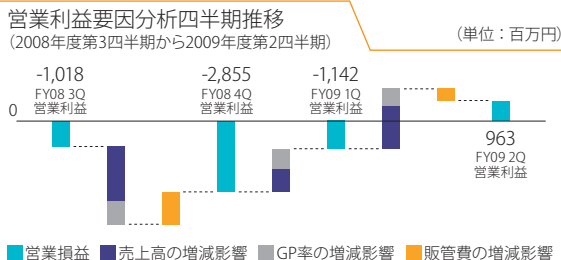
高輝度LEDの高品質、高歩留まり生産を実現するサファイア基板のSDプロセスを搭載したレーザー加工装置です。フルオートマッチックによる高精度で安定した加工が可能です。

製品情報 <http://www.disco.co.jp/jp/products/laser/>



経費圧縮の効果として

経費管理を徹底的に見直したことで売上高の回復により、2009年度第2四半期には営業利益がプラスに転じました。また、7月から経費管理レベルをFからEへ変更しました。



FY08.3Q→4Q

不況対策効果で
販売管理費
約13億円圧縮

FY08.4Q→FY09.1Q

一時帰休や
経費管理の徹底により、
販売管理費は横ばい

FY09.1Q→2Q

売上高大幅回復により、
販売管理費
約5億円増加

不況への取組み



① 工場新棟建設計画の見直し

- <桑畑工場>
機能縮小によるコストダウンの実施
- <茅野工場>
建設を一時中断

② 経費管理レベルF実施

2008年10月に、経費管理レベル^{*1}をF²に変更

*1 売上高経常利益率に連動し、A～Fまで6段階に経費支出のガイドラインを設定しています

*2 レベルFでは、お客さまへの製品・サービスの提供に直接関係がある経費以外の支出を徹底的に見直します

③ 人件費の抑制

- 役員報酬・賞とおよび管理職の給与を減額
- 本社・広島事業所における一時帰休の実施
- 残業を^{ゼロ}0に規制

半導体メーカーは高速・大容量化、小型・微細化、低消費電力化など一層の技術革新や更なる生産性向上に取り組んでいます。こうした流れを受け、ディスコでは、ウェーハの極薄化、多彩な切断技術、生産コスト低減に向けた製品開発などに注力しております。このページでは『SEMICON Japan 2009』へ出展しました新製品の一部をご紹介します。

フルオートマッチングレーザー DFL7161



現行のフルオートマッチングレーザー「DFL7160」の後継機として、Low-kグルーピング、Siウェーハ、化合物半導体等のレーザーファルカットなどに対応した、「生産性」「信頼性」などの装置基本性能を大幅に向上したフルオートマッチングレーザー。

フルオートマッチンググラインダ・ポリッシャ DGP8761 (サファイア基板用特殊仕様)



加工難易度の高いサファイア基板の薄化(研削・研磨)工程を1台の装置で全自動にて完結させるプロセスを開発しました。今回の開発により、LED製造に関わる加工ステップの短縮、環境負荷の低減を実現しました。

全自動ダイシングソー DFD6760



ウェーハの300mm化など生産コスト低減に向けた取り組みが進んでおり、更なる生産性向上要求に応えるために、2チャックテーブル・2スピンドル構造の300mmウェーハ対応全自動ダイシングソーを新たに開発いたしました。

全自動ダイシングソー DFD6341



より一層のコスト低減要求に対応するため、世界各国で多数の販売実績のある現行機DFD6340に改良を加え、更なる生産性向上を実現した2スピンドル構造の200mmウェーハ対応全自動ダイシングソーDFD6341を新たに開発しました。



DISCO Information

会社情報および株式の状況(2009年9月30日現在)

会社概要

本社所在地	東京都大田区大森北二丁目13番11号
創業年月日	1937年5月5日
設立年月日	1940年3月2日
資本金	14,517百万円
従業員数	単体1,683名 連結2,464名
主な事業内容	精密加工装置 <ul style="list-style-type: none"> → 製造および販売 → メンテナンスサービス → オペレーションやメンテナンスの研修サービス → 解体リサイクル事業 → リースおよび中古品売買
	精密加工ツール → 製造および販売
	精密部品の有償加工サービス

役員

代表取締役会長	溝呂木 斉	常勤監査役	玉利 晋
代表取締役社長	関家 一馬		巳亦 力
常務取締役	関家 圭三		高柳 忠雄
取締役	関家 英之	監査役	浅海 芳久
	梶山 啓一		黒沼 忠彦
	田村 隆夫	執行役員	荒井 一尚
			吉永 晃

株式概要

上場市場	東京証券取引所 市場第一部(証券コード6146)
発行済株式総数	34,004,418株
株主数	13,647名
大株主	日本トラスティ・サービス信託銀行(株) : 4,193千株 / 12.33% 日本マスタートラスト信託銀行(株) : 2,806千株 / 8.25% (株)ダイイチ企業 : 1,998千株 / 5.88% (株)ダイイチホールディングス : 1,998千株 / 5.88% (株)OctagonLab : 1,704千株 / 5.01% 関家 臣二 : 1,360千株 / 4.00% (株)オレンジコーラル : 1,146千株 / 3.37% 資産管理サービス信託銀行(株) : 820千株 / 2.41% 日本生命保険(相) : 819千株 / 2.41% タイヨウファンド, エル.ピー. : 809千株 / 2.38%

株主メモ

事業年度	4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
期末配当金	
受領株主確定日	3月31日
中間配当金	
受領株主確定日	9月30日
同連絡先	〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 TEL 0120-232-711 (通話料無料) 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
公告の方法	電子公告により行う ただし、やむを得ない事由により電子公告ができないときは日本経済新聞に公告いたします。

株式会社 ディスコ

143-8580

東京都大田区大森北 2-13-11

http://www.disco.co.jp/



この冊子はアメリカ大豆協会認定の大豆油インキを使用しています。